

## 性能特点

- 在低压力下达到低热阻的效果
- 硬度低，贴合性好
- 卓越的耐高低温性，极好的耐气候性、耐辐射及卓越的介电性能
- 卓越的化学和机械稳定性
- 应力低，更为有效地保护电器元件
- 玻纤基材抗穿刺、抗剪切、抗撕裂

## 产品描述

PAKCOOL® TP-215-FG 导热垫片在设计上成功融合了高导热特性、柔软及弹性等优势。本系列产品具备广泛的导热系数，能够适应不同的应用场景。本产品为电绝缘材料，即使在较低的压力下，也能有效填充热源与散热器之间的空隙，确保优异的热传导效果。本产品压强 5-100 psi (0.03-0.69 MPa) 的压力下具有最佳导热性能。本产品规格灵活，可根据客户需求定制尺寸。

PAKCOOL® TP-215-FG 还特别添加了超薄玻璃纤维增强层，这一设计不仅提升了材料的操作性和耐用性，而且确保了即便在进行冲孔、条带式裁剪或非标准形状设计时也不会破裂或变形。此外，其含玻璃纤维的导热硅胶片采用单面自粘设计，保证了粘合性长久不衰退，同时也不会对金属表面产生腐蚀影响。

## 典型应用

- LED
- 功率模块
- 集成芯片
- 电源模块
- 车用电子产品
- 通讯设备
- 计算机及其附件

## 技术参数

特性	TP-215-FG	测试方法
颜色	粉红色	目测
导热系数 (W/m·K)	1.5	ASTM D5470
热阻@20psi, 0.5mm (K-in <sup>2</sup> /W)	0.91	ASTM D5470
厚度* (mm)	0.3—5.0	ASTM D374
密度 (g/cm <sup>3</sup> )	2.60±0.05	ASTM D792
硬度 (Shore 00)	75±10	ASTM D2240
抗拉强度 (Psi)	≥200	ASTM D412
体积电阻率 (Ω·cm)	≥1.0×10 <sup>13</sup>	ASTM D257
介电强度 (kV/mm)	≥12	ASTM D149
介电常数 (100KHz)	4.5	ASTM D150
阻燃性	V-0	UL94
连续使用温度 (°C)	-40~200	--
*标准厚度 (mm): 0.3, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5		

本数据仅可用于指导，并不可用于作为产品规范。

## 产品配置

- 可根据客户的要求进行裁切
- 无背胶
- 标准尺寸为 200mm × 400mm, 也可根据客户要求定制

## 包装储运

- 常温、通风干燥处保存、避免阳光直射
- 建议储存期限：24 个月

本说明书的数据是实验室条件下获得。但因为使用环境、工艺等差异，所以不能保证产品在某些用法与用途上的正确性和适用性。用户在使用时，一定要先进行测试，以确认适合您使用目的的产品。如您在使用本产品中出现任何问题，欢迎和我司技术部门联系，我们将尽力为您提供帮助。